

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2019-029

环旭电子股份有限公司

关于全资子公司在巴西设立合资公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司 Universal Global Electronics Co., Limited（以下简称“环海电子”）与 Qualcomm Incorporated（以下简称“高通公司”）之全资子公司 Qualcomm Technologies, Inc.（以下简称“Qualcomm Technologies”）于 2018 年 2 月 6 日签署了《合资协议》，拟在巴西投资设立合资公司，主营业务为研发、制造具有多合一功能的系统级封装（System-in-Package, “SiP”）模块产品，应用于智能手机、物联网等相关设备。经协议双方估算，合资公司前 3 年运营所需资金总额为 18,800 万美元，其中 50% 由协议双方提供给合资公司，另外 50% 由合资公司进行融资。根据签署的《合资协议》的条款，双方预计资本总投入为 9,400 万美元，其中环海电子出资 7,050 万美元，持股比例为 75%；Qualcomm Technologies 出资 2,350 万美元，持股比例为 25%。具体详见公司于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的公告》（公告编号：临 2018-006）。

二、对外投资进展情况

2019 年 3 月 29 日，公司收到了巴西经济部国税局签发的营业登记税证号（CNPJ），现将相关信息公告如下：

公司名称：SEMICONDUCTORES AVANCADOS DO BRASIL S.A.（先进半导体（巴西）股份有限公司）

注册地：AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, No. 85, 6TH FLOOR, ROOM 665-A, IN THE CITY OF SÃO PAULO, STATE OF SÃO PAULO

(巴西圣保罗州圣保罗市罗伯托马里尼奥新闻人大道 85 号 6 楼 665-A 室)

注册号码：33.155.125/0001-40

注册号码签发日期：2019 年 3 月 27 日

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日